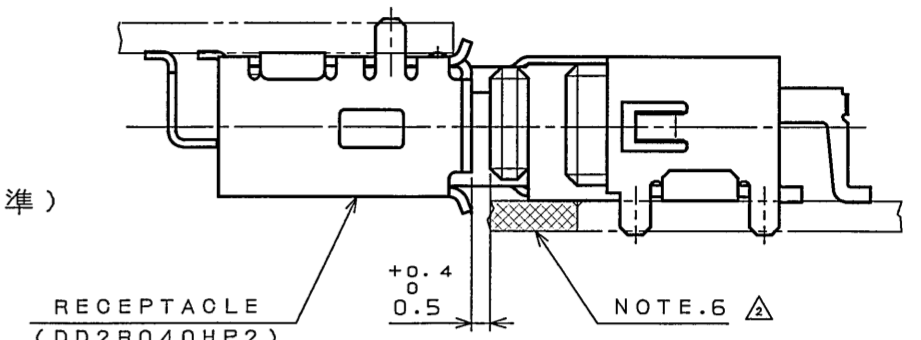
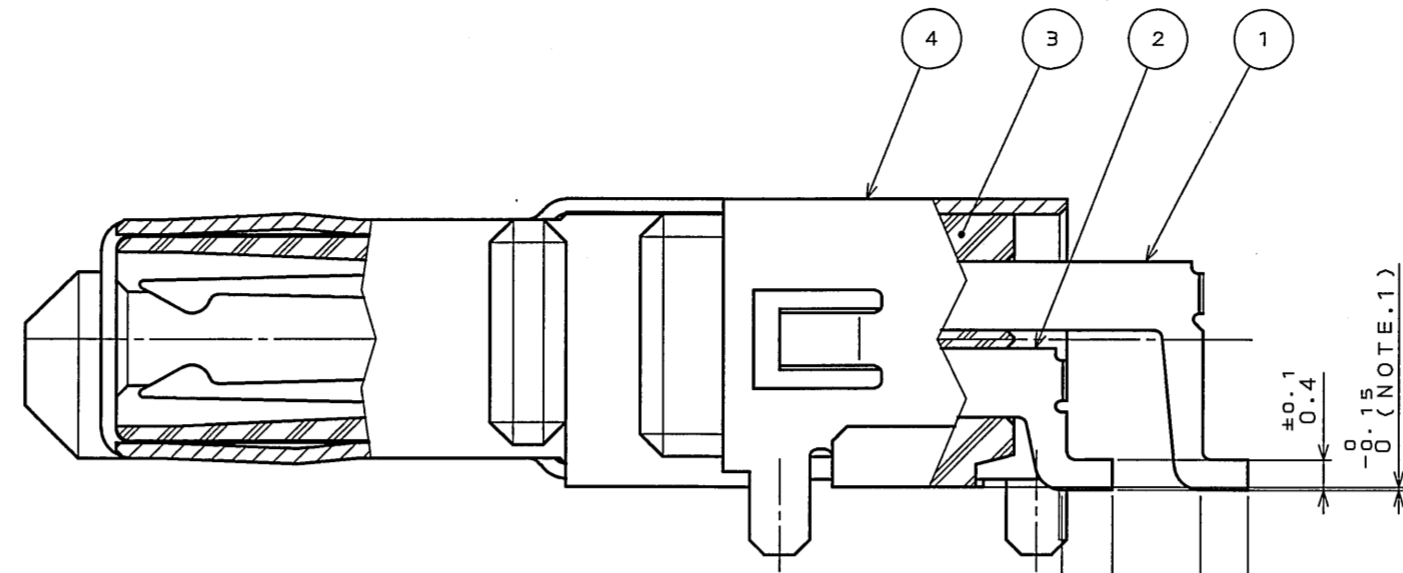
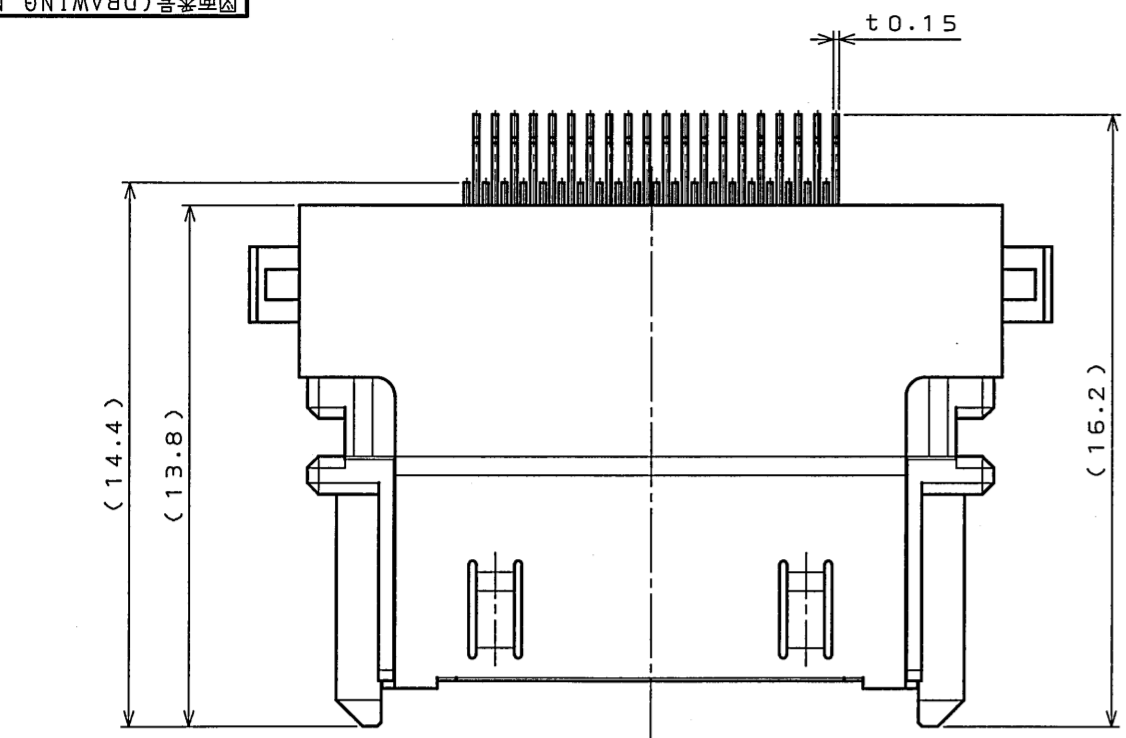
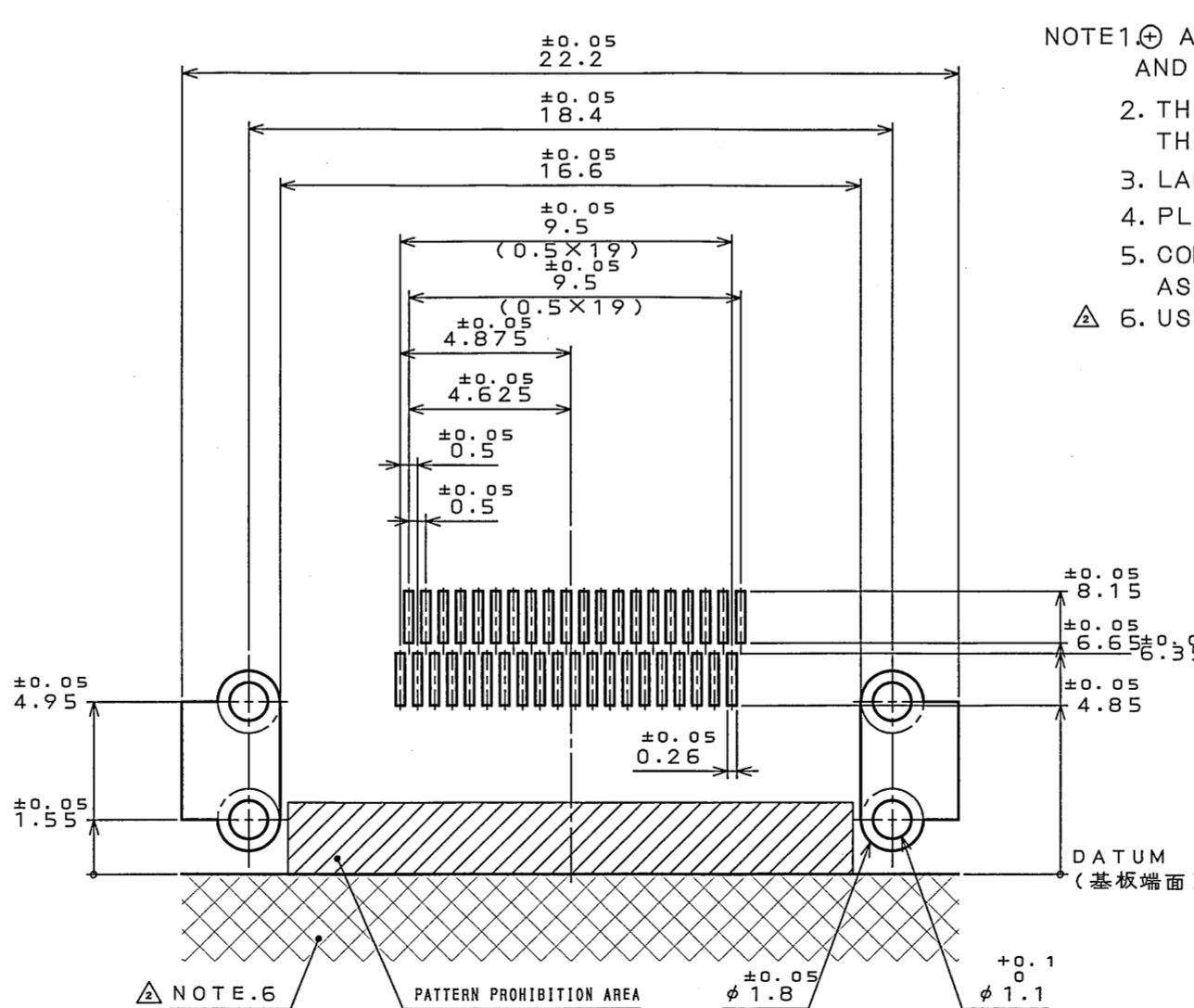
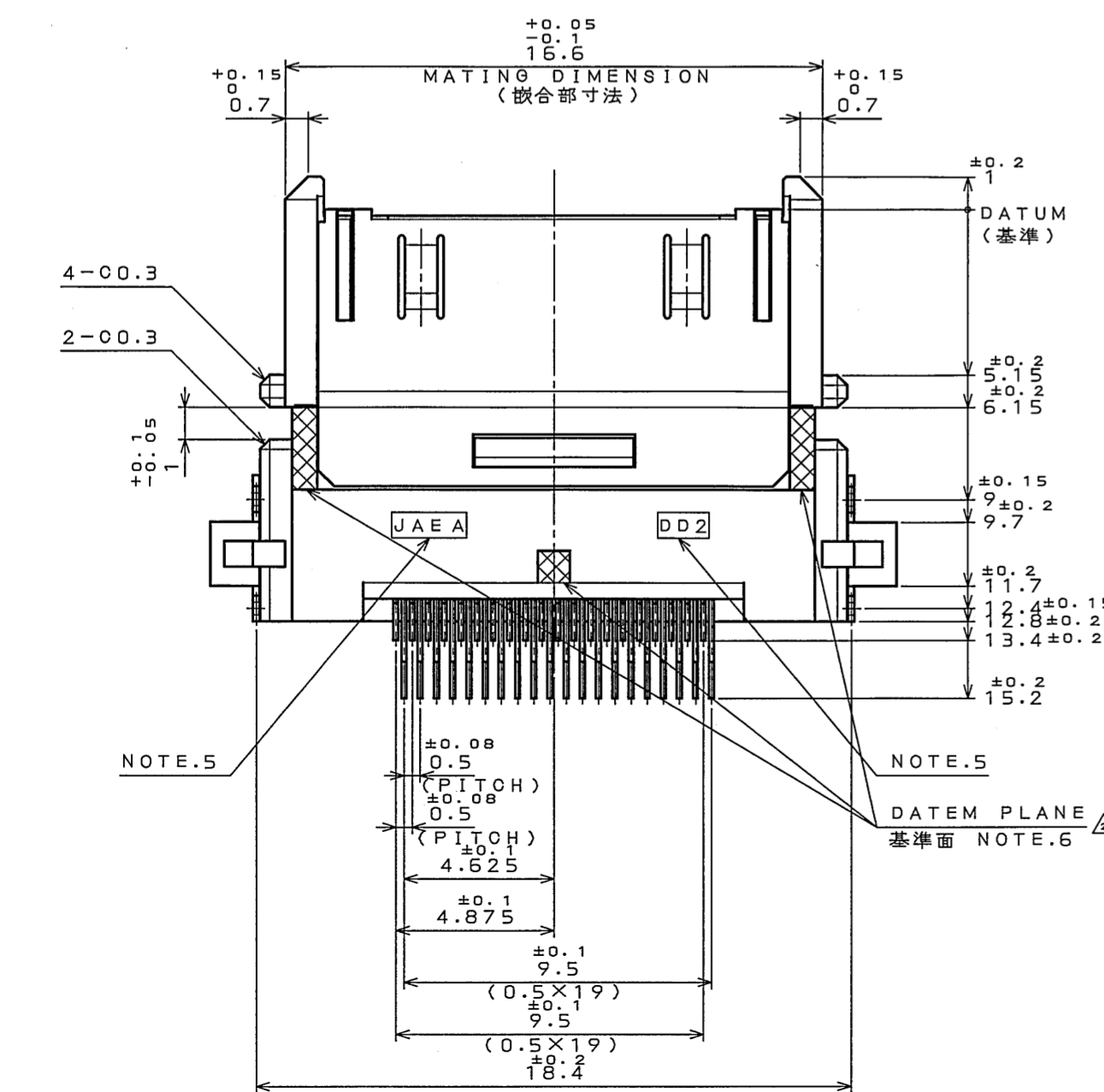
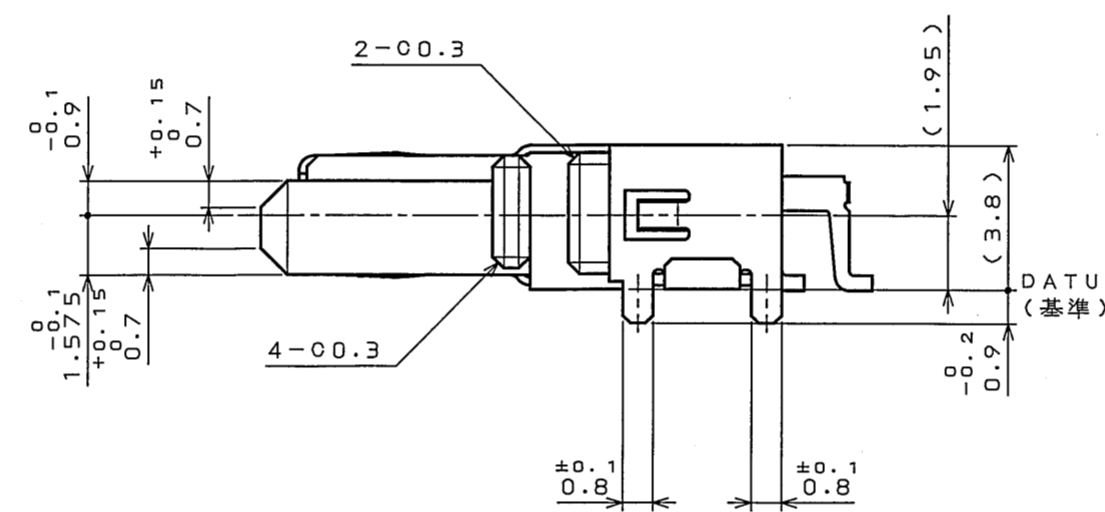
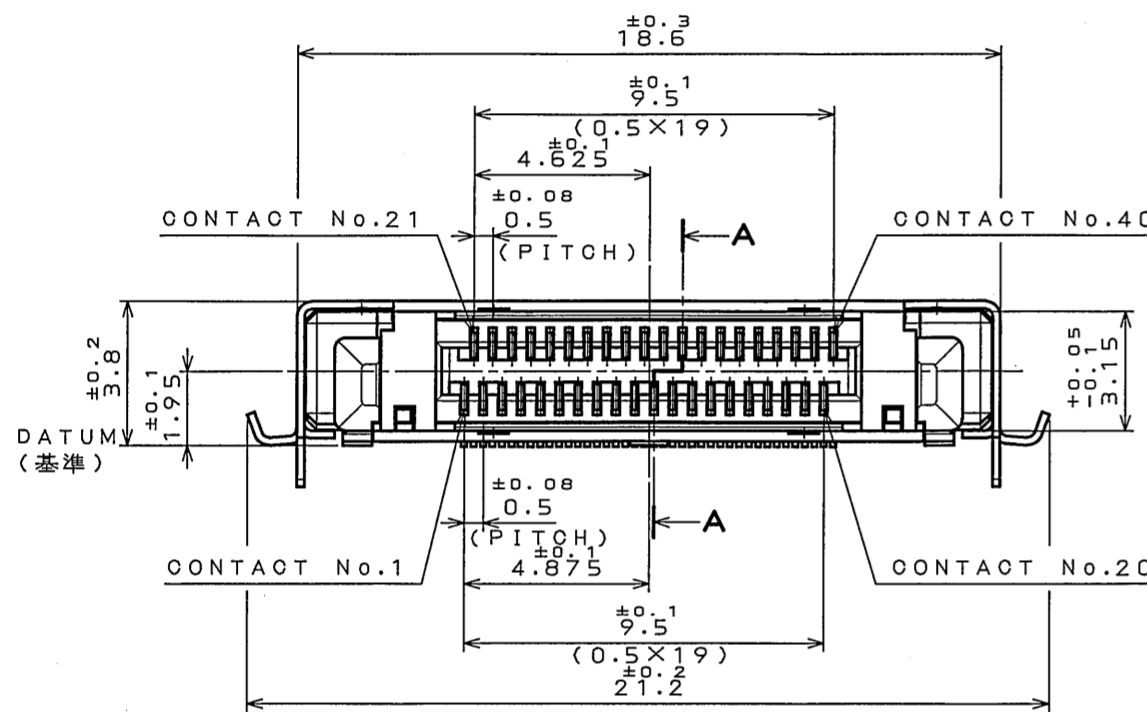


REV.	DATE	DON NO.	DESCRIPTION	DR.	CHK.	APPD.	APPD.
2	30.Jun.2004	055150	CORRECT AN ERROR ETO		Y.SATOU		H.Amemiya



SECT. A-A
(SCALE 10:1)

MATING (REF.)



APPLICABLE P.C.B (REF.)
適合基板寸法 (参考)

- NOTE 1 ⊕ AND ⊙ DENOTE ARE DIPECTION OF SMT TOLERANCE DIMENSION IS 0^{-0.15} AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
- THE HOLD-DOWN SHALL BE INSIDE THE INSULATOR JUDGING THE LOWEST CONTACT POSITION. THE COPLANARITY AMONG THE HOLD-DOWNS AND CONTACTS SHALL BE 0.1 MAX.
 - LAND MARK BOTH SIDES OF P. C. B. HOLE IS THROUGH HOLE PLATED.
 - PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.
 - COMPANY LOGO "JAE" AND CAVITY NUMBER "A OR B" AND PART NUMBER "DD1" ARE MARKED AS INDICATED.
 - USE JIG OR DISPOSABLE BACKUP BOARD FOR DATUM PLANE (3 AREA) RETENTION.

- 注 1. SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は "0^{-0.15}" であり、公差内におけるバラつき (1コネクタ内のMAX値とMIN値の差) は 0.1 以下とする。
- ホールドダウンは、コンタクトの基板側最下位置を基準にインシュレータ側にあるものとし、コンタクトを含めたバラつきは 0.1 以下とする。
 - ランドは基板の両側に設けること。また、スルーホールの穴はスルーホールメッキであること。
 - 図に示す範囲 (斜線部) コネクタ下部) をパターン禁止領域とする。
 - 図示の位置に社標 "JAE"、キャビ番号 "A" または "B" 及び品名 "DD2" を表示する。
 - リフロー時は、基準面 (3ヶ所) を治具または捨て基板にて保持すること。

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING THROUGH HOLE AREA: TIN PLATING	
3	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	(BLACK)	UL94V-0
2	CONTACT 2	20	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL SMT AREA: GOLD FLASH PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA A2: 0.1μm MIN.
1	CONTACT 1	20	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL SMT AREA: GOLD FLASH PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA A2: 0.1μm MIN.

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30011	第1版 (ORIGINAL DATE) 23.Feb.2004	尺度 (SCALE) 5:1	列-ス (SERIES) DD2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
製造 DR.	担当 CHK. Y.SATOU	名称 (TITLE) DD2B040HA2	Referenc	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	承認 APPD. H.AMEMIYA	図面番号 (DRAWING NO.) SJ100281	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		承認 APPD.	重量 (WEIGHT)	版数 (REV.) 2